

Samsung Electronics запускает массовое производство высокоплотной памяти для смартфонов ePoP

06.02.2015

Сеул, Корея — 4 февраля 2015 — Samsung Electronics, лидер по производству памяти, начал серийное производство первой в отрасли мобильной памяти типа ePoP (embedded package on package, встроенный пакет в пакете). ePoP состоит из 3 ГБ ОЗУ типа LPDDR3, 32 ГБ флеш-памяти eMMC и управляющего контроллера.

Очень тонкий модуль ePoP создан для использования в современных изящных смартфонах премиум-класса: благодаря компактному расположению элементов в едином пакете, такую память можно поместить непосредственно над мобильным процессором, не занимая дополнительного места. Это упрощает инженерную задачу размещения элементов в сверхтонких корпусах современных смартфонов по сравнению с устройствами, в которых установлена распространенная сегодня двухпакетная память типа eMCP.

«Модули высокоплотной памяти ePoP для флагманских смартфонов позволят компании Samsung предложить пользователям устройства с примечательным дизайном, увеличив при этом время работы аккумулятора и скорость выполнения многопоточных задач, — рассказывает Джи-хо Пэк (Ji-ho Baek), старший вице-президент подразделения маркетинга памяти компании Samsung Electronics. — Мы планируем расширить линейку модулей ePoP в течение следующих нескольких лет. Новые устройства будут обладать повышенной производительностью и плотностью записи данных. Такая память должна усилить премиум-сегмент смартфонов, сделав их преимущества еще более явными».

Оперативная память LPDDR3 интегрированного модуля ePoP демонстрирует прекрасную скорость передачи данных ввода-вывода — 1866 Мбит/с и поддерживает 64-битную полосу пропускания ввода-вывода.

Применение ePoP отлично скажется на конструктивных особенностях смартфонов, позволяя экономить внутреннее пространство корпуса, высвобождая место для важных компонентов, например — более емких аккумуляторов. Важные преимущества ePoP — устойчивость к нагреву и тонкость — позволяют помещать модуль непосредственно над мобильным процессором без риска повредить флеш-память (обычно флеш-память чувствительна к высоким температурам, поэтому ее устанавливают подальше от процессора, который при работе нагревается).

Модуль занимает площадь всего 15x15 мм, что на 40% меньше по сравнению с традиционной памятью. Высота решения ePoP составляет 1.4 мм.

Подобные системы уже используются в носимой электронике Samsung. Теперь же OEM-производители смогут применять их в своих мобильных устройствах — планшетах и смартфонах.